

# 落子电摩与算电两大赛道 宁德时代一日两扩产业版图

记者 王子霖

4月8日,宁德时代接连传出两条重磅合作消息:一是宁德时代正式回应与张雪机车的合作,落子电摩赛道;二是宁德时代拟出资41亿元认购中恒电气控股股东新增注册资本,将与中恒电气在算电协同领域展开战略合作。

## 一天公布两笔重要合作

先看宁德时代与张雪机车的合作。针对宁德时代子公司新能安在社交媒体发布的“张雪机车×新能安,好戏正开场,敬请期待”的视频,宁德时代4月8日对外回应表示,双方确实在初步接洽电摩合作。

再看宁德时代与中恒电气的合作。中恒电气4月8日晚公告称,公司控股股东中恒科技投资及其股东朱国锭、包晓娟与宁德时代签署《战略合作框架协议》,宁德时代拟以41亿元认购中恒科技投资新增注册资本1441.18万元,并达成多项业务合作。

增资后,中恒科技投资注册资本将变更为2941.18万元。中恒科技投资股东朱国锭、包晓娟分别持有中恒科技投资35.70%股权和15.30%股权,宁德时代将持有49.00%股权。

据公告,中恒科技投资将促进宁德时代与中恒电气围绕绿色ICT基础设施、交通电动化、新型电力系统(算电协同)等领域开展相关业务及战略合作,整合资源禀赋,赋能公司发展。

同时,宁德时代将通过一定方式参与中恒电气的公司治理。具体包括:中恒科技投资将促使宁德时代推荐的1名符合证券监管要求的上市公司董事候选人履行上市公司相关审议程序后担任上市公司董事;促使宁德时代推荐的1名符合证券监管要求的上市公司副总经理候选人履行上市公司相关审议程序后担任上市公司副总经理。

## “宁王”产业版图持续扩大

一天之内先后传出两则重磅合作消息,宁德时代加



速扩大产业版图的意图清晰可见。

斥资41亿元战略入股中恒电气控股股东,标志着宁德时代与中恒电气的合作从过往的换电柜采购关系,迈向更高层次的深度绑定与产业协同。

据4月8日披露的合作协议,双方合作将全面升级至绿色ICT基础设施、交通电动化以及新型电力系统(算电协同)等

核心战略领域,宁德时代还将通过推荐董事及副总经理人选参与上市公司治理。

另一端的布局同样值得关注。通过控股子公司新能安与张雪机车接洽电摩合作,宁德时代正在将动力电池技术向高端电动摩托车赛道延伸。新能安由宁德时代与新能源科技(ATL)合资设立,专注于短途出行、家储、无人机、电动工具等领域的电动化应用。今年1月,宁德时代在回答投资者提问时明确表示,公司与ATL优势互补,全面推进电动二轮车等应用领域的电动化。此次与张雪机车合作的赛道级电摩项目,是其在电动二轮车高端赛道上落下的关键一子。

# 误导性陈述导致信披违法 向日葵及时任高管被处罚

记者 张雷

一则重组公告引发的“纸上富贵”最终以受罚收场。

向日葵4月8日晚公告,公司及相关当事人收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》。因在重大资产重组预案中对标的资产盈利模式的描述存在误导性陈述,公司及时任董事长吴少钦、时任董事会秘书李岚合计被处以510万元罚款。

## 交易所四问标的资产

2025年9月22日,向日葵披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟收购漳州兮璞材料科技有限公司(简称“兮璞材料”)100%股权及浙江贝得药业有限公司40%股权,交易预计构成重大资产重组。

该预案披露后,向日葵股价连续三个交易日涨停,成交量显著放大。

2025年12月26日,深圳证券交易所创业板公司管理部针对前述预案事项向公司下发关注函,围绕向日葵本次重组标的资产兮璞材料的多个疑点展开问询。

首先,针对预案中披露的“定制化代工+自主生产”模式

及依托漳州、兰州两家工厂的说法,深交所要求公司说明兮璞材料的实际产能分布情况,核实两家工厂的审批、建设及投产进展,并确认预案相关内容是否准确。

其次,预案称兮璞材料主营高端半导体材料,但媒体报道其实际从事电子氟化液的贸易活动,深交所据此要求公司补充披露2023年、2024年各产品的收入、成本及毛利率,以及向上海德恩新材料科技有限公司采购电子氟化液的金额、具体用途、与核心产品的关联,并核查双方是否存在关联关系。

再其次,深交所还关注本次重组是否会新增重大不利影响的同业竞争或严重影响独立性的关联交易。

最后,针对媒体披露的兮璞材料实际控制人陈朝琦因1680万元商业纠纷被起诉一事,深交所要求公司说明涉诉具体情况,对兮璞材料生产经营的影响,以及是否会对资产过户构成法律障碍。

## 公司及高管被罚510万元

2026年1月14日,向日葵公告,因收到中国证监会《立案告知书》,根据相关规定,公司不符合发行股份购买资产的条件,终止本次重组事项。

重组虽然终止,但违法违规披露的法律后果并未因此免除。浙江证监局后续查明,上述预案披露兮璞材料的主要盈

利模式为“定制化代工+自主生产”相结合。然而,截至披露日,兮璞材料自有工厂仍在建,尚不具备自主生产能力,且主要产品系标准化产品,前述盈利模式描述与实际不符,构成误导性陈述。

监管部门认定,向日葵上述行为违反证券法第七十八条第二款,构成第一百九十七条第二款所述误导性陈述违法行为。时任董事长吴少钦参与案涉交易事项,未能保证信息披露真实、准确、完整,为直接负责的主管人员;时任董秘李岚未勤勉尽责,为其他直接责任人员。

综合当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,浙江证监局决定:对向日葵给予警告,并处以300万元罚款;对吴少钦给予警告,并处以150万元罚款;对李岚给予警告,并处以60万元罚款。

向日葵表示,本次涉及的信息披露违法违规行为不触及重大违法强制退市情形。目前公司生产经营正常,提醒投资者理性投资,注意风险。

记者了解到,已有部分受损投资者向绍兴市中级人民法院提起证券虚假陈述责任纠纷诉讼并获得立案受理。律师提示,在2025年9月22日至2025年12月25日期间买入向日葵股票,并在2025年12月25日收盘时仍持有该股票的受损投资者,或可向公司索赔。

# 山东省国资委拟实控嘉华股份

记者 孙小程

4月8日晚,嘉华股份公告称,公司控股股东拟变更为山东省土地发展集团(下称“土地集团”),公司实际控制人将由张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟变更为山东省国资委。

4月1日,嘉华股份公告称,收到实际控制人张冠玲出具的《关于筹划股份转让事宜的通知函》,获悉张冠玲及公司主要股东正在筹划公司股份转让事宜,可能导致公司实际控制人发生变更。

拆解此次披露的易主方案,核心步骤共三步:协议转让、解除一致行动关系及表决权放弃、定增。

4月7日,土地集团与张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、田丰(以下简称“转让方”)签署《股份转让协议》,约定土地集团通过协议转让方式取得转让方持有的公司3622万股股份(占公司总股本的22.01%)。

根据约定,在完成前述股份转让后,张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟解除了一致行动关系。同时,转让方及股东YUWEI WU分别签署了《表决权放弃承诺》,承诺在规定时间内不可撤销地放弃其持有上市公司全部股份对应的表决权。

以股份协议转让事项的成功实施为前提,嘉华股份将推进定增事宜。4月7日,公司与土地集团签署了《附条件生效的股份认购协议》,土地集团拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过2143万股(含本数),发行完成后,土地集团持有上市公司股份的比例为31.00%。

据公告,嘉华股份每股发行价格为17.30元/股,定增发行价格为12.40元/股,公司停牌前收盘价为16.24元/股。据此估算,山东省国资委收购嘉华股份控制权约需8.9亿元。

土地集团主业为土地等自然资源的保护、开发、利用和管理。最新的财务数据显示,土地集团2024年营收为107亿元,净利润为4.5亿元。

谈及收购嘉华股份的目的,土地集团表示,基于对上市公司内在价值的认同及长期投资价值判断,拟通过本次收购获得上市公司的控制权。本次对上市公司控制权的收购有助于提升土地集团资产证券化水平,增强资本运作能力,推动集团高质量发展。

# 持续加大研发力度谋新求变 东北制药“老药厂”迸发“新动能”

近日,东北制药披露2025年年度报告。2025年,公司实现营业收入70.75亿元;归母净利润2.6亿元;经营活动产生的现金流量净额为11.06亿元,同比增长45.81%;公司拟向全体股东每10股派现0.55元(含税)。

东北制药是方大集团旗下上市公司,前身为东北制药总厂,始建于1946年,公司历经80年的发展和文化传承,积累了深厚的品牌底蕴,连续多年被评为中国医药工业百强企业、中国化学制药工业百强企业。公司坚持党建引领,全面加强党的建设,推动党建工作与生产经营深度融合,助推企业高质量发展。

面向未来,公司将持续秉持“党建为魂”的企业文化,深化品牌优势,着力把东北制药打造成国际知名、国内领先的大型综合性医药健康产业集团。

## 持续深耕精细化管理企业竞争力稳步提升

2025年,面对行业同质化竞争加剧、存量市场增长空间收窄等多重压力,公司广大干部职工,坚持党建引领,团结奋进、攻坚克难,全力冲刺年度生产经营任务目标。对内深耕精细化管理,全面提质增效,对外紧盯市场动态,不断优化研发资源配置与产品矩阵布局,厚植竞争新优势,持续提升安全、环保、质量等基础工作水平,筑牢企业发展根基,推进企业高质量发展与核心竞争力稳步提升。

报告期内,公司实现营业收入70.75亿元;归属于上市公司股东的净利润2.6亿元。截至2025年12月31日,公司总资产128.90亿元;归属于上市公司股东的净资产55.30亿元,同比增加3.91%。

2025年,公司主业结构持续优化,医药制造与医药商业双轮驱动格局进一步巩固。医药制造业务实现收入38.98亿元,占总营收比重达55.10%;医药商业业务实现收入30.26亿元,占比42.78%;两大主业合计贡献97.88%的营收,收入结构持续向高毛利制造端倾斜。

## 持续加大研发力度项目引进成效凸显

年报数据显示,2025年公司研发投入2.06亿元,同比增长38.5%,研发人员增加76人,同比增长9.76%,同时研发人员中

博士人数、硕士人数、30岁以下人数分别同比增长60.00%、66.97%和79.66%,主要原因是2025年公司集中招聘应届硕博研发人员106人,用于补充生物药和化学药的研发人员,并优化人员结构。

公司表示,2025年,公司持续加大新产品研发力度,聚焦优势治疗领域和产品集群,坚持仿制药与创新药“双轮驱动”。通过强化研发节点管理、优化并行研发流程,提升研发质量管理,加速推进在研项目进度。依非韦仑原料药完成CDE审评并获上市申请批准通知书,左乙拉西坦缓释片、左卡尼汀口服溶液液获药品注册证书。

依非韦仑片(200mg)、多替韦钠片、恩格列净片、玛巴洛沙韦原料药4个仿制药新产品注册申报获得受理。推进研发项目储备池建设,挖掘潜力品种,全年盘活活谷维素等两个老品种。公司持续发力生物药赛道,鼎成肽源研发管线稳步推进,重点项目取得关键进展并获得重要批件。

## “一体两翼”创新突破

2026年是东北制药持续深化改革、加速推进高质量发展的重要一年,更是公司实施“一体两翼”战略的第一年(一体:做优做强化学仿制药;两翼:一是生物医药,二是大健康产品和中药),做好各项工作责任重大、意义重大,对公司全体员工也提出了新的、更高的要求。

2026年,公司将围绕创新发展战略规划,统筹推进各项重点工作,持续高效推进重点在研项目,推动创新药参与国际多中心临床研究及海外授权合作,加速创新药国际化进程,拓展丰富抗体及ADC类药物研发管线,前瞻布局下一代技术平台,构建差异化竞争优势。

围绕公司战略发展方向:公司将持续加大关键领域中高端人才的引进力度,聚焦具备核心技术能力的优质研发团队,为公司长远发展积蓄动力;公司将坚持“创新驱动、数智赋能、绿色转型”战略,聚焦公司价值链智能化升级。升级私有化算力中心,推动AI技术深度融入研发、生产、营销各环节,释放数据核心价值;深化重点工艺智能管理体系建设;完善“人才培养+创新应用”机制,加速创新成果转化落地。

# 三大场景重塑先进封装价值 奥芯明携手ASMP 提供设备解决方案

记者 李兴彩

“人工智能、高速通信与新能源汽车等三大应用场景的快速发展,正在重塑芯片技术路线图,先进封装的重要性凸显,并对半导体设备商提出新的挑战与需求。”近日,半导体设备公司奥芯明首席执行官许志伟在接受上海证券报记者采访时表示,先进封装已成为半导体发展的新战略高地。

许志伟介绍,作为国内领先的半导体设备供应商,奥芯明传承ASMP的全球领先技术与经验,并深度结合本土研发与供应链优势,以“本土创新+全球引领”的协同策略,为中国客户提供高性能、高适配性且可靠的半导体封装解决方案。

## 三大场景为先进封装设备注入新动能

“在AI等高性能计算芯片快速发展的需求下,先进封装已成为半导体产业升级的核心技术路线。”记者日前走进奥芯明位于SEMICON China 2026的展台,正被参观人群团团围住的许志伟直言不讳地表示,先进封装在产业链中的重要性和价值占比已经被重估。

在许志伟看来,人工智能、高速通信与新能源汽车等三大应用场景的快速发展,带动了AI算力芯片、高速互连芯片等市场的快速增长。但面对摩尔定律放缓,解决单芯片算力提升无法跟上AI爆发式需求的困境,无论是采用“多芯粒Chiplet先进封装与异构集成技术”做大芯片算力,还是采用超节点实现集群算力,都对先进封装带来新的挑战和需求,也给相关设备公司带来新发展机遇。

Counterpoint高级分析师威廉表示,先进封装已不再仅仅是芯片制造的配套环节,其正成为AI规模化部署的关键制约因素,增长可见性可延伸至未来多年。Yole预测,先进封装市场将在2030年超过794亿美元,2024年至2030年的复合年增长率(CAGR)达9.5%,AI与高性能计算需求成为主要驱动力。

先进封装正给半导体设备商带来新机遇。Yole称,2025年后端设备总收入约为70亿美元,预计到2030年将突破90亿美元,年平均复合增长率接近6%。随着芯片制造复杂性的不断提升,包括固晶机、倒装芯片贴片机、热压键合等在内的后道设备已成为推动半导体技术创新的战略重点。

在SEMICON China 2026上,长电科技首席执行官郑力表示,原子级封装是先进封装领域的精度革命,将彻底重构芯片集成逻辑,ALD(原子层沉积)设备、TSV(穿透硅通孔)工艺设备、混合键合设备、ALE(原子层刻蚀机)设备等等则是其中的核心设备。

## 两大新品引领先进封装工艺革新

在本次展会上,奥芯明携ASMP首发两大新品:一是最新款引线键合平台AERO PRO;二是ALSI LASER 1206全自动裸晶圆处理系统。

许志伟介绍,引线键合平台AERO PRO专为高密度、超细间距先进封装打造,支持直径小至0.5密耳超细引线,兼具高速与超高精度,可满足系统级封装(SiP)、多芯片组件(MCM)等复杂封装的多样化生产需求。该设备搭载全新专利换能器技术X Power2.0,实现X/Y轴双向能量均匀传输,使得球形键合点一致性大幅提升;全新高速高精度工作台与无摩擦引环线,显著降低转轴磨损,长期稳定性更强;支持最大140mm×300mm高密度基板,兼容混合引线键合工艺,可适用于SiP、MCM、存储器件等多种封装类型。

记者了解到,ALSI LASER 1206激光切割开槽设备,搭载专利多光束紫外激光技术,将单光束转化为矩阵多光点,在保证加工效率的同时大幅降低热影响区,有效减少毛刺、崩边与芯片强度衰减,完美适配硅、碳化硅、氮化镓等先进半导体材料。

许志伟介绍,ALSI LASER 1206设备定位精度小于1.5微米,开槽工艺支持60微米至800微米厚度晶圆,切割工艺可处理20微米至200微米超薄晶圆;集成涂覆、切割、清洗一体化工位,支持膜框与裸晶圆全自动处理,是专为先进封装、人工智能、车用功率器件及移动终端等高增长领域打造的晶圆前道处理方案,切实助力客户实现更高良率与更低成本。

## 携手ASMP赋能中国半导体生态

奥芯明虽然成立于2023年,但绝不是行业新兵,其是全球排名前三的半导体组装机及封装设备制造商ASMP在中国设立的独立品牌。

“中国半导体封装行业持续快速发展,早已是ASMP公司的重要市场。”对于成立奥芯明,许志伟介绍,中国半导体已从低端制造阶段进入对中高端工艺和系统能力的真实需求期,在TSV、Chiplet、2.5D\3D等先进封装领域取得长足进展,面对中国半导体产业链本土化、自主化进一步加快的机遇和挑战,奥芯明将发挥本土供应链优势,与ASMP携手发挥“本土创新+全球引领”的协同策略,为中国客户的更多需求做定制化开发、在地化服务。

在本次展会上,奥芯明也携手ASMP及战略合作伙伴,围绕人工智能、超级互联、智能出行等三大核心应用场景,向行业展示了其整合关键工艺、赋能行业应用的端到端解决方案能力。

许志伟介绍,在人工智能的核心互连环节,公司和ASMP构建了支持高密度2.5D/3D封装的NPL系列平台,全面覆盖晶圆及面板级扇出型封装、TCB、混合键合工艺;在超级互联场景,公司针对800G/1.6T光模块、CPO共封装光学、硅光集成与高速数据中心需求,可提供低损耗、高可靠的封装方案;在智能出行领域,公司可提供从功率模块到传感器的全场景车规级封装方案,满足高可靠、高散热、高鲁棒性要求。

展望2026年发展,许志伟说,公司将重点做好三件事:一是推动更多由国内团队主导的自主研发设备进入量产与市场验证阶段,逐步构建独立技术闭环;二是进一步深化与头部客户的协同开发关系,完成从“设备供应商”向“工艺合作伙伴”的转型;三是在先进封装和高端应用市场中形成可复制的解决方案能力。